Sep., 2005

文章编号: 1000-324X(2005)05-1215-07

多乳氮化硅 / 碳化硅复合材料制备的反应机理分析

张 雯, 王红洁, 金志浩, 白 玉 (西安交通大学金属材料强度国家重点实验室,西安 710049)

摘 要: 为了探索碳热还原法制备多孔氮化硅/碳化硅(Si3N4/SiC)复合陶瓷材料在高温阶段 的反应机理,采用固化的酚醛树脂为碳源,通过热解产生具有反应性的碳,使之在1300~1780°C 等不同温度下与表面包裹的氮化硅粉反应, 氩气为保护气氛. 通过对试样的 XRD 、 TEM 分 析和显微结构观察,结合反应的热力学和动力学结果计算推测,树脂裂解碳与 Si_3N_4 反应生成 SiC 的机理主要为 Si₃N₄ 分解生成 Si(1) 与 C 进一步发生的液 - 固反应, 和 Si(1) 与反应过程中 的中间产物 CO(g) 之间发生的液 - 气反应. 其他还包括 C 与 SisN4 间直接进行的图 - 固反应; C与Si₃N₄表面的SiO₂间的气-固反应以及由SiO(g)、Si(g)参与的气-固反应。树脂裂解 碳与 Si₃N₄ 从 1400°C 左右开始发生反应形成 SiC, 温度升高对 SiC 层的生长有促进, 保温时间 的延长对 SiC 层的生长厚度影响较大。

关键词: 反应机理,多孔陶瓷;氮化硅;碳化硅

中图分类号: TQ 174 文献标识码: A

1 引言

多孔陶瓷材料作为一类先进的结构功能一体化材料,被广泛地应用于生物、环保、化 工、电子、能源等各个领域[1]. 随着其应用范围的不断扩大, 为适应更为苛刻的应用环境, 对此类材料的物理和化学等各方面性能要求也不断提高。近年来,利用纳米碳化硅作为增 强相制备复合陶瓷材料的研究有重大的突破。 Niihara 等人首先报道了向陶瓷基体中添加少 量粒径范围在 20~300nm 的 SiC 颗粒,可使材料的强度和断裂韧性都大幅增加的现象 [2],其 优异的性能受到了广泛地关注. 在此基础上又先后制备了抗弯强度高达 800MPa, 断裂强度 为 3.5MPa·m^{1/2} 的 Al₂O₃/SiC 致密陶瓷 [3], 以及抗弯强度为 1.3GPa、断裂强度为 7MPa·m^{1/2} 的 Si₃N₄/SiC 致密陶瓷 [4]. Si₃N₄/SiC 复合陶瓷材料不但有优异的机械性能,还有良好的抗 热震性能、抗氧化和抗腐蚀性能,若能将这些优异的性能与材料的结构设计相结合,制备 出多孔 Si₃N₄/SiC 复合陶瓷材料,应能胜任许多场合下的应用要求.为此, Yang 等人利用 纳米碳粉为碳源,采用常压烧结进行碳热还原,原位生成纳米碳化硅颗粒的方法,先后制 备了强度为 20~100MPa, 气孔率达 50%~70% 的多孔 Si₃N₄/SiC 陶瓷 [5,6]. 本课题组也依据此 原理、选用酚醛树脂替代纳米碳粉作为碳源,并引入凝胶注模成型工艺,制备了具有较高 强度和较高气孔率的多孔 Si₃N₄/SiC 陶瓷 ^[7]. 目前, 此类研究多集中在材料的制备方法和材 料性能的测试方面,对整个烧结过程中涉及的反应机理讨论较少.事实上,利用酚醛树脂 作为碳源,在反应烧结过程中涉及的反应较为复杂.不但包括酚醛树脂裂解碳源的活性问

收稿日期:2004-08-06, **收到修改稿日期**:2004-10-29

基金项目: 国家高技术研究发展专项 (863)(2004AA649350)

作者简介: 张 雯 (1974-), 女,博士研究生. E-mail: zhangwen@mail.xjtu.edu.cn

题,还包括 Si_3N_4 粉体本身以何种形式参与反应的问题.这些因素都直接影响到反应生成 SiC 的形貌、大小及分布,进而影响到多孔 Si_3N_4/SiC 陶瓷材料的性能.为此,本文重点考察烧结过程中的树脂裂解碳进行碳热还原制备多孔 Si_3N_4/SiC 复合陶瓷材料的反应机理.

2 实验

实验采用的氮化硅粉 (平均粒径 $<0.5\mu m$, α 相 >94%), 酚醛树脂牌号为 2130. 固化剂为 六次甲基四胺.

首先将酚醛树脂加入适量固化剂,在 60°C 条件下恒温 10h 使树脂完全固化,将固化的树脂制成 10mm×10mm×5mm 的试样块,表面磨光.石墨坩埚中铺一层氮化硅粉,放入试样块,继续铺粉直至试样块被完全埋住.注意埋粉量要足够,以确保高温下反应的需要.

试样放入真空炉中,升温速率为10°C/min,800°C以前抽真空,真空度为100Pa.800°C以后通氩气,氩气压力为100kPa,升温至所设定温度后保温一段时间(设定温度分别为1300、1400、1500、1780°C;保温时间分别为1、2、3h).经高温处理后的试样选择相同部位,进行下一步测试。利用 XRD-6000 型 X 射线衍射分析仪分析试样表面的物相组成; MEF3大型金相显微镜观察反应生成碳化硅的情况。生成的 SiC 平均层厚由照片中直接量取,平均每组取三张照片,每个部位测量 25 个值,再取平均值得到。

利用凝胶注模工艺制备多孔 Si₃N₄/SiC 陶瓷材料, 酚醛树脂含量为对氮化硅粉重 15wt%的试样, 素坯放入真密炉中, 800°C 通氩气, 1400°C 保温 2h, 再在氮气氛下烧结, 终温度 1780°C, 保温时间为 1h. 烧结试样经离子减薄做透射分析。用 JEM-200CX 透射电镜观察酚醛树脂加入后对试样微观结构的影响。

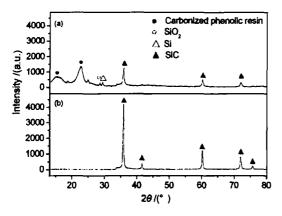


图 1 1500°C(a) 和 1780°C(b) 氩气氛下保温 2h 试样的 XRD 图谱

Fig. 1 XRD patterns of samples soaked at (a) 1500°C, (b) 1780°C for 2h under Ar atmosphere

3 结果和讨论

3.1 XRD 分析

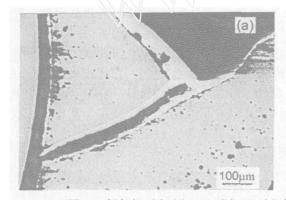
图 1 为试样在不同温度、氩气氛下保温 2h 的 XRD 谱图. 从峰型和出峰位置的对比可以看出,当温度于 1780°C 时,只出现典型的 β-SiC 衍射峰,说明试样表面完全被 SiC 所覆盖,而且层厚较大,已无法检测出底层物质;而在 1500°C 时,也显示出了β-SiC 的特征峰,说明在此温度下已有 SiC 生成,但除此之外,还有一些其他峰存在. 由于生成的 SiC 层还较薄,酚醛树脂碳化后出现的热解碳峰被检测出来. 2θ 约为 16°处的一个宽峰为碳化酚醛树脂中形成的无序石墨片层 [8]; 2θ 约为 23°处还有一个强度

较高的宽化的峰,此峰是酚醛树脂裂解碳的半结晶结构呈现出的石墨 (002) 峰,由于不是很规整的晶态结构或形成的晶粒非常细小,所以峰型会发生宽化 ^[9]. 从 XRD 谱图中还可以发现 1500° C 时有少量的 SiO_2 和 Si 存在, SiO_2 来源于 Si_3N_4 的表面氧化,而游离硅则是在 Ar 气氛下 Si_3N_4 发生分解形成的.

3.2 热力学和动力学分析

800°C 以前,体系中的主要反应是酚醛树脂的裂解,整个裂解过程主要是释放出小分子物质,包括 CO、 H_2 、 CH_4 等。裂解完成后的化学组成与纳米碳粉基本相似,残碳量约为原酚醛树脂量的 50%.由于裂解过程始终抽真空,真空度为 100Pa,故可忽略裂解气氛对后期反应的影响。在 1000°C 以下, Si_3N_4 粉都不会有明显的变化。 Si_3N_4 表面覆盖有少量的 SiO_2 ,因此,在高温 1300°C 时体系中含有的主要成分为:树脂裂解碳、 SiO_2 和 Si_3N_4 .

对于 C 与 SiO₂ 生成 SiC 反应,总反应式为 SiO₂(s)+3C(s)→SiC(s)+2CO(g),这一反应在无氦气的惰性气体气氛下,实验证明可以进行得非常完全。目前,大部分学者认为此反应实际上是分为两步骤完成的,第一步先生成 SiO, SiO₂(s)+C(s)→SiO(g)+CO(g); 然后 SiO 再进一步与 C 反应生成 SiC, SiO(g)+2C(s)→SiC(s)+CO(g). C 与 SiO₂ 涉及的反应类型主要为气。固反应,虽然此体系中 SiO₂ 的含量很少,但它的存在为整个反应体系提供了 CO(g) 的一个重要来源,对体系的反应机理有重要影响。本体系中大量存在的 Si₃N₄,C 与 Si₃N₄ 的 反应为 Si₃N₄(s)+3C(s)→3SiC(s)+2N₂(g),热力学计算 [10] 显示,C 与 Si₃N₄ 的固。固反应由低温的非自发转变为高温下的自发进行,而保护气氛为氩气,使反应能够顺利地进行。研究表明 [11],此反应在 1527°C 左右被抑制的一个重要原因就是平衡常数小,只有 3.743. 当温度升高时,其平衡常数随之呈指数上升,化学平衡向碳化硅增多的方向移动。在 1727°C 左右,平衡常数比在 1527°C 大了两个数量级。因此,高温情况下, Si₂N₄ 可通过与 C 的固。固反应生成 SiC. 但如图 2 显微结构照片所示,由树脂裂解碳形成的内部气孔壁上也有明显的 SiC 层形成,而它们是不可能与 Si₃N₄ 粉体直接接触,生成 SiC 的量之多仅用 C 与 SiO₂ 的气。固反应是无法解释的。因此,二者必然还有其他的反应方式。



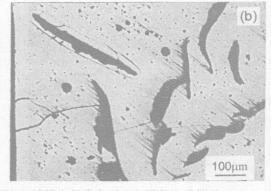


图 2 氩气氛下在 (a)1500; (b) 1780°C 保温 2h 试样内部孔表面 SiC 层的生成情况

Fig. 2 SiC outgrowth on the inner surfaces of samples soaked at (a) 1500, (b) 1780°C for 2h under Ar atmosphere

热力学计算显示, Si_3N_4 的分解反应在标准状态下、 1500° C 左右不能自发进行,而本体系中反应是在氩气氛下进行的,不存在氦气对分解的抑制,因此 Si_3N_4 有一定程度的分解. W. Hincke 和 H. D. Batha 等人先后对 Si_3N_4 的分解进行了研究,并分别提出了表述分解温度 (T_d) 与相应温度条件下的氦气压力 (P_d) 之间的关系,计算式为

$$2.3\lg P_{\rm d} = 19.75 - 44500/T_{\rm d} \tag{1}^{[12]}$$

$$2.3\lg P_{\rm d} = 20.85 - 44500/T_{\rm d} \tag{2}^{[13]}$$

根据上述公式计算的结果见表 1. 可见,氮气的分压越小, Si_3N_4 开始分解的温度就越低,在氩气氛下 1500° C 分解反应完全可以进行. 由于硅由固态到液态的相变温度为 1412° C, 所以,此温度下分解产生的硅是以液态形式存在的. 由于硅在玻璃态碳和石墨上的润湿角

分别为 50° 和 10°[14], 具有很好的润湿性, 因此毛细作用迫使液相硅通过孔隙向内部渗入, 同时与接触到的碳发生反应生成 β-SiC. 由于液相硅在孔道内的传输速率比 Si(l) 与 C 之间 的反应速率大 5 个数量级 [15], 因而可以认为体系中各部位的 Si(1) 和 C 之间的反应是同时开 始的. 随着反应时间的延长, 生成的 β -SiC 层会不断增厚.

表 1 N₂ 压力对 Si₃N₄ 分解温度的影响 Table 1 Effect of N2 pressure on the decomposing temperature of Si₃N₄

Pressure/10 ⁵ Pa	Decomposing temperature/K	
	Formula(1)	Formula(2)
1	2253	2134
0.1	2018	1922
0.01	1828	1749
0.001	1670	1604
0.0001	1537	1481

根据上述分析, 1500°C 下生成 SiC 的 一个主要原因是 Si₃N₄ 分解为液态的硅和 氮气,液态硅通过毛细管作用扩散,进一步 与热解碳反应得到 SiC, 此步反应自发进行 的趋势很大,由图 2 内部孔壁生成 SiC 的情 况也可以支持这种反应机理的推断,一般 连通孔孔隙较大时才会在其表面形成 SiC 层, 裂纹太小, 液相无法渗入的孔内无 SiC 形成. SiC 的膨胀系数与树脂裂解碳相差 较大,致使表面形成明显的裂纹.

Favre 等人 [16] 的研究均显示, Si(1) 和 C(s) 的反应可分为两个阶段, 第一阶段是两 者迅速反应形成 SiC(s), 第二个阶段受 Si(l)

通过 SiC 层的扩散速率控制。Ar 气氛下,1600°C、5min 就可生成 4μm 左右的 SiC 层;而 1600°C、 24h 生成的 SiC 层厚与 1600°C、 0.5h 的情况相似, 仅有 10μm 左右, 从图 2 可以 看出, SiC 的层厚远大于 10μ m. 因此,除了 Si_3N_4 分解形成的 Si(1) 和 C 之间的反应外,应 该还有气相参与的反应存在.

前面提到了 C 与 SiO₂ 生成 SiC 反应过程中有 CO(g) 生成; 另外, 因为体系中还存在杂质 氧,在富碳的环境中可形成 CO(g),研究表明 [16],体系中只要存在极少量的氧,就可引起下列一 系列反应: $2Si(l)+CO(g)\rightarrow SiC(s)+SiO(g)$; $Si(l)+CO(g)\rightarrow C(s)+SiO(g)$; $2C(s)+SiO(g)\rightarrow SiC(s)+SiO(g)$ CO(g); 2Si₃N₄+3CO(g)→3SiC(s)+3SiO(g)+4N₂(g). 杂质氧在反应中起到一种媒介的作用,不 断地将 C(s) 转变为 CO(g), 进一步将 C 传递下去, 由于此反应系统中 Si(l) 是大量的, 因此, Si(l) 与 CO(g) 的气 - 液反应也是形成 SiC 的重要因素之一.

同时,在高温条件下,硅的蒸汽压较大, Si(g), SiO(g) 成为参与反应生成 SiC 的另一原 因,这类气相参与的反应在 1780°C 时不能忽视,它是造成 SiC 层随反应时间的延长持续增 厚的主要原因.

3.3 温度和保温时间对生成 SiC 的影响

图 3 展示了不同温度对试样表面 SiC 层生成的影响. 由图可知温度的影响非常显著. 直接影响到 SiC 层是否生成,生成的形态和厚度. 1300°C 以下反应基本不发生. 随温度升 高, 化学反应逐渐转变为自发, 化学反应速度也迅速增大. SiC 层开始生成时在同一平面上 连续但不均匀,一般认为这是由溶解-析出机制决定的[17].碳在硅溶液中溶解形成过饱和 溶液,然后 SiC 晶粒从此过饱和溶液中析出.碳的形貌对晶粒的生长方向有很大的影响. 碳在硅溶液中溶解是一个放热反应,熔解热为-247kJ/mol; SiC 从溶液中析出也应是一个放 热反应,因为碳和液态硅反应的热效应为 -115kJ/mol^[18]. 这些放出的热使体系局部温度升 高,进一步促进了 Si₃N₄ 的分解, SiC 的异相成核和生长,逐渐形成了连续的 SiC 层. 显微 结构照片显示温度在 1500°C 以上得到的 SiC 层已较为均匀. 温度升高加剧了 Si₃N₄ 的分解 和气相的扩散,同样保温时间 1780°C 的 SiC 层厚明显高于 1500°C 的情况.

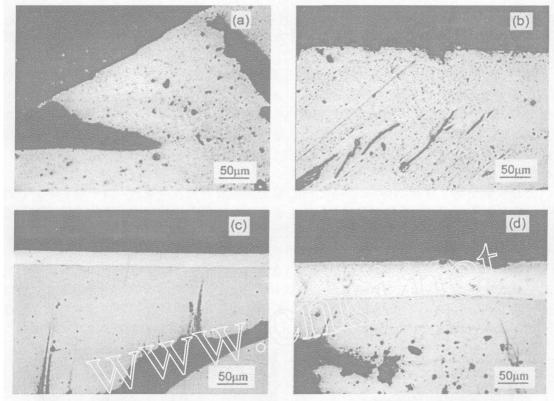


图 3 在 (a) 1300, (b) 1400, (c) 1500, (d) 1780°C 氢气氛下保温 2h 试样表面 SiC 层的生成情况 Fig. 3 SiC outgrowth on the surfaces of samples soaked at (a) 1300°C, (b) 1400°C, (c) 1500°C, (d) 1780°C for 2h under Ar atmosphere

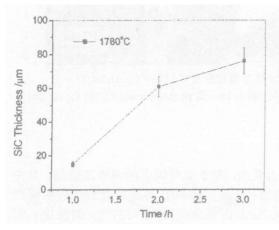


图 4 Ar 气氛下 1780°C 保温不同时间试样表面 SiC 层厚的变化

Fig. 4 Thickness of SiC outgrowths on the surfaces of samples soaked at 1780° for different times under Ar atmosphere

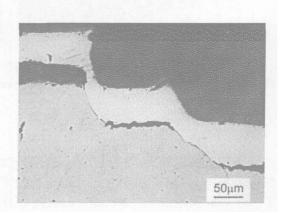


图 5 树脂裂解碳表面平整程度对 SiC 层的厚度 的影响

Fig. 5 Effect of the surface roughness of pyrolytic carbon on thickness of SiC outgrowths

图 4 表明了氩气氛下保温不同时间试样表面 SiC 层的厚度变化情况. 由 XRD 谱图可

知,在 1500°C 时形成的 SiC 层中含有很少量的硅,而在 1780°C 时已经检测不出硅的存在,因此,对 1780°C 不同时间处理的样品用统计方法近似得出 SiC 的层厚.由图可见,保温时间的延长 SiC 层的生长厚度也随之增大.

另外,树脂裂解碳表面平整度对层厚的影响也较大.图 5 为 1780°C, Ar 气氛保温 2h 所得试样的情况.由此可以看到,若表面不平, SiC 层的厚度会有很大的差别.平台部分 SiC 的层厚相近,台阶部位随坡度的缓急,层厚也作相应变化.坡陡部位液相难于滞留,是起始阶段由 Si(l)与 C 生成的 SiC 层厚度较薄.从而佐证了固-液反应的存在.表层形成 SiC 层后晶粒择向生长,使平台部分加厚,而坡度部分生长缓慢.

3.4 TEM 分析

上述实验是为了探讨制备多孔 Si_3N_4/SiC 复合陶瓷材料的反应机理. 由于在实际制备过程中,酚醛树脂和 Si_3N_4 粉是均匀混合的,生成 SiC 的过程不容易观察,因此采用了这种办法. 在对实际 Si_3N_4/SiC 复合陶瓷材料在研究过程中,我们同样发现了表明存在液 - 固反应的证据. 在 TEM 照片中,不但可以看到大小在 $50\sim300$ nm 左右、分布在 Si_3N_4 棒状晶之间的 SiC 颗粒,也发现了棒状晶内存在的晶粒,如图 6(a). 这些晶粒开始很小,随着反应时间的延长逐渐长大。而含树脂裂解碳量较高的试样中, Si_2N_4 棒状晶有明显的分解迹象,长度变短,除了 SiC 和 Si_3N_4 典型的衍射花样外,部分柱状晶的衍射花样呈现玻璃相特征,如图 6(b) 所示。这也从另一个角度表明了生成多孔 Si_3N_4/SiC 复合陶瓷材料反应的机理。

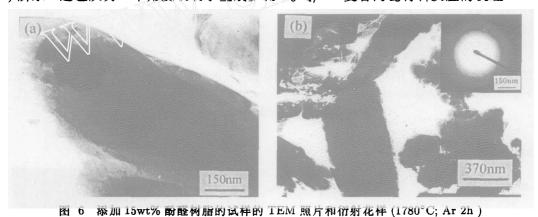


Fig. 6 TEM photos and diffraction patterns of samples with 15wt% phenolic resin (1780°C; Ar 2h)

4 结论

- 1. 树脂裂解碳与 Si_3N_4 反应生成 SiC 机理较为复杂,对于氩气氛下的两步法烧结,其主要机理为 Si_3N_4 分解生成 Si(1) 与 C 进一步发生的固 液反应和 Si(1) 与反应过程中的中间产物 CO(g) 之间发生的气 液反应. 还包括 C 与 Si_3N_4 表面氧化的 SiO_2 间的气 固反应; C 与 Si_3N_4 间直接进行的固 固反应由 SiO(g) 、 Si(g) 参与的气 固反应.
- 2. 树脂裂解碳与 Si₃N₄ 从 1400°C 左右起开始发生反应形成 SiC. 形成初期连续但不均匀, 温度升高可促进 SiC 的生成, 改善 SiC 层的均匀性, 树脂裂解碳本身表面平整程度对 SiC 层的厚度有很大的影响. 部分连通的内部孔壁上也生成 SiC 层. 温度升高有利于 SiC 层的生长, 保温时间的延长对 SiC 层的生长厚度影响较大.

参考文献

- [1] Ishizaki K, Komarneni S, et al. Porous Materials, London: Kluwer Academic Publisher, 1998. 181-198.
- [2] Niihara K. J Ceram Soc Jpn, 1991, 99 (10): 974-972.
- [3] Zhao J, Sterns L C, Harmer M P, et al. J Am Ceram Soc, 1993, 76 (2): 503-510.
- [4] Hirano T, Niihara K. Mater. Lett, 1995, 22 (4-6): 249-254.
- [5] Yang J F. J. Am. Ceram. Soc., 2001, 84 (7): 1639-1641.
- [6] Yang J F, Zhang G J, Kondo N, et al. Acta Materialia, 2002, 50 (19): 4831-4840.
- [7] 张 雯, 王红洁, 金志浩, 等 (ZHANG Wen, et al). 无机材料学报 (Journal of Inorganic Materials), 2004, 19 (4): 743-748.
- [8] Tzeng S S, Chr Y G. Materials Chemistry and Physics, 2002, 73 (2-3): 162-169.
- [9] Cheng H M, Endo H, Okabe T, et al. Porous Meter, 1999, 6 (3): 233-237.
- [10] 叶大伦, 胡建华, 实用无机物热力学数据手册, 第二版, 北京; 冶金工业出版社, 2002, 6-25,
- [11] 李 虹, 黄莉萍, 蒋 薪 (LI Hong, et al). 无机材料学报 (Journal of Inorganic Materials), 1996, 11 (2): 35-42.
- [12] Hincke W, Brantly L R. J Am Chem Soc, 1930, 52 (1): 48-52.
- [13] Batha H D, Whithey E D. J Am Ceram Soc, 1993, 56 (9): 365-369.
- [14] Whalen T J, Anderson A T. J Am Ceram Soc, 1975, 58 (3): 396-403.
- [15] Greil P, Lifka T, Kaindl A. J Eur Ceram Soc, 1998, 18 (14): 1961-1973.
- [16] Favre A, Fuzellier H, Suptil J. Ceramics International, 2003, 29 (3): 235-243.
- [17] Scace R I, Slack G A. J. Chem. Phys, 1959, 30 (6): 1551-1555.
- [18] Hauttmann S, Kunze T, Muller J. Thin Solid Films, 1998, 328 (1-2): 175-179.

Reaction Mechanism of Preparing Porous Silicon Nitride/Silicon Carbide Composite Ceramics

ZHANG Wen, WANG Hong-Jie, JIN Zhi-Hao, BAI Yu

(State Key Lab for Mechanical Behavior of Materials, School of Materials Science and Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

Abstract: The reaction mechanism of preparing porous silicon nitride/silicon carbide (Si₃N₄/SiC) composite ceramics was investigated by using solidified phenolic resin as carbon source. Argon was used as protective atmosphere. The polymer can pyrolyze to provide free carbon, and farther react with Si₃N₄ powder coated at different temperatures ranged from 1300°C to 1780°C. XRD, TEM, the microstructure of the samples, the thermodynamics and kinetics analysis show that the reaction mechanism mainly associates with liquid-solid reaction between C and Si(l) decomposed from Si₃N₄, and liquid-gas reaction between Si(l) and CO(g) which is the intermediate product during the reactions. Other reaction types involved are solid-solid reaction between C and Si₃N₄, gas-solid reaction between C and SiO₂ coated on the Si₃N₄ powder, and gas-solid reaction between C and SiO(g) or Si(g). The reactions between pyrolyzed carbon and Si₃N₄ begin at 1400°C, and form SiC layer. Keeping in higher temperatures can improve the formation of SiC layer and the prolongation of soaking time can increase the thickness of SiC layer significantly.

Key words mechanism; porous ceramics; silicon nitride; silicon carbide